

供媒体立即发布

投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

针对 KLA-TENCOR 的 28XX 缺陷检测系统推出的新 XP 升级将提供更强的灵敏度、产能、缺陷良率相关性

【加州 Milpitas 2009 年 6 月 30 日讯】专为半导体和相关产业提供工艺控制及良率管理解决方案的全球领先供应商 KLA-Tencor 公司（纳斯达克股票代码：KLAC）为 28XX 宽频明场检测系统发布了一款新的升级包——XP。XP 升级包是市面上第一款可为检测系统提供标准集成电路设计布局文件（让光罩车间能够形成光罩图案的指令）的产品。得到此信息后，检测系统就能掌握电路内的缺陷位置，以更好地估算其影响产品良率的概率。此外，XP 能够利用与设计结合的晶片检测结果识别在光刻时可能对工艺变化特别敏感的光罩上的特征。XP 升级包的这些及其它功能的设计旨在提升现有 28XX 检测机台的灵敏度与产能，并增加缺陷结果的信息内容以有助于加快查找和解决缺陷问题。

KLA-Tencor 的晶片检测事业群 (Wafer Inspection Group) 副总裁兼总经理 Mike Kirk 博士表示：“在以消费者为导向的市场中，芯片复杂度与价格压力不断增加，我们的客户正在寻求便于进行缺陷根源分析的工具，以提高产能并实现更快和更有效的达到稳定生产。如今，业界领先的晶片厂必须运用让 193nm 光刻能够印制几近十分之一光照波长线宽的特征的先进光刻技术，目前这种线宽已经可以用可数的原子来度量。在此环境下，即使是一片晶片上的最小缺陷或一个光罩上的介于临界点的图案也会产生巨大的良率影响。我们新的 XP 升级包能满足我们客户对优化缺陷捕捉，以及从无关或杂讯缺陷的海洋中识别系统性缺陷和其他与良率相关的缺陷的需求，这代表了一个巨大的进步。此外，XP 能够以具有成本效益的方式提供这种有价值的功能：作为大多数领先晶片厂中已有检测系统的一个升级。”

新的 XP 升级包内含专为改善检测结果或检测机台产能而设计的若干功能，其中包括：

- 基于缺陷位置的电路图案的密度，在检测期间对良率相关缺陷的优先捕捉；
- 利用电路设计信息并根据特定图案组设置高度局部化的缺陷检测阈值，对芯片内所有关键区域的缺陷捕捉进行优化。
- 通过密切监测具有最小工艺灵活度的图案类型，实现对临界点光刻状况的早期侦测；以及
- 新工艺层或新装置的衍生“配方”（对检测具有决定性影响的光学、机械和算法参数设置）的线下生成。作为若干配方快速化的功能之一，此功能可大幅减少配方设置所需的时间和劳力，藉此提高检测机台的产能，并让即使是对小批量或快速试制的芯片配方优化也切实可行。

XP 升级包是针对已被广泛采用的 281x 和 282x 明场检测系统的一项升级，已出货至多家晶片代工厂、内存芯片与逻辑芯片生产厂家，且在 20 多篇技术论文中都有专门论述。

关于 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司（纳斯达克股票代码：**KLAC**）是工艺控制与良率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与度量技术。这些技术为半导体、数据存储、化合物半导体、光伏及其它相关纳米电子行业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，三十余年来为客户努力打造优秀的解决方案。**KLA-Tencor** 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (**Milpitas**)，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P)

前瞻性声明：

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于向更小关键线宽及深亚波长光刻的预期技术转移，解决有关此预期转移挑战的 **XP** 的能力，以及 **XP** 的预期性能（包括我们的客户通过利用 **XP** 升级包而可能实现的其缺陷捕捉增强功能和优势）等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(**Private Securities Litigation Reform Act of 1995**) 规定的“安全港”(**Safe Harbor**) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题）或影响我们产品运用或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###